

TP600 系列

导热硅胶垫片

TP600是一种高热导率材料，在低压下具有很高的适应性。当与电子元件组装在一起时，它在低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电绝缘特性。可稳定工作在-40℃~150℃，满足UL94 V0阻燃等级要求。



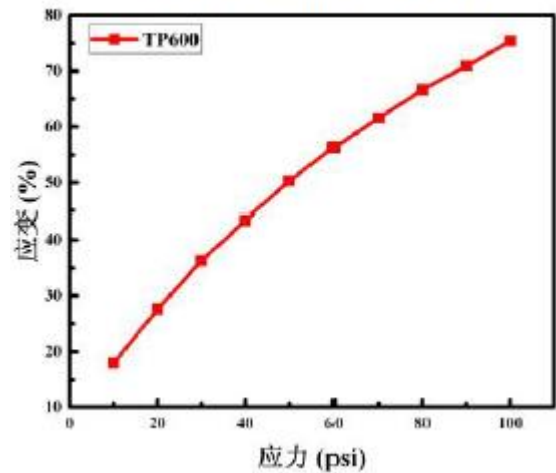
特性与优点

- 导热系数: 6.0 W/m.K
- 高性能
- 不导电
- 超低压缩
- 性能优良，操作简单

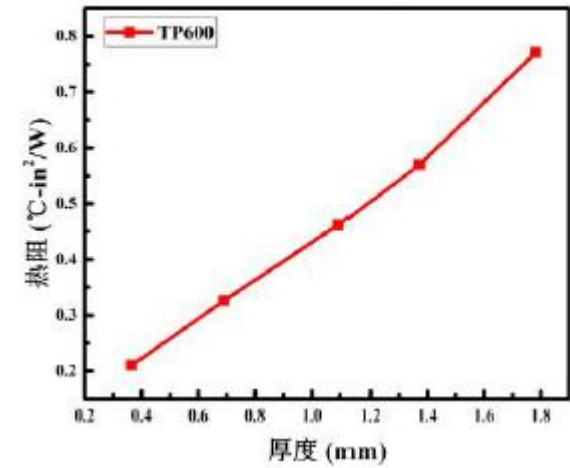
典型应用

- 电压调节模块 (VRMs)
- ASICs和DSPs
- 高导热需求的模块
- 高速大存储驱动
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM
- 网络通信设备

形变与压力关系图



厚度与热阻关系图



典型属性		
属性	典型值	测试方法
	TP600	-
成分	有机硅+陶瓷	-
颜色	暖红色	目视
厚度(mm)	0.5~10.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.285	ASTM D792
硬度(Shore OO)	60	ASTM D2240
耐温范围(°C)	-40~150	/
电性能		
击穿电压(kV/mm)	> 5.0	ASTM D149
体积电阻率 (Ω.cm)	10 ¹²	ASTM D257
介电常数@1MHz	7.9	ASTM D150
防火性能	V-0	UL 94
导热性能		
导热系数(W/m-K)	6.0	ISO 22007-2
热阻 (°C·in²/W) @20psi · 1mm	0.138	ASTM D5470

*厚度公差±10%

存储：
● 储存于阴凉、干燥、通风环境

保质期：
● 12个月。